

<<电子器件导论>>

图书基本信息

书名：<<电子器件导论>>

13位ISBN编号：9787810457644

10位ISBN编号：7810457640

出版时间：2001-1

出版时间：北京理工大学出版社

作者：包兴，胡明主编

页数：454

字数：678000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子器件导论>>

### 内容概要

本书系统介绍了电子元气件的基本性能及各种参数意义。

并介绍了电子元气件的生产工艺和在实际中的应用，同时对于目前一些新的微电子技术和表面组装技术也作了介绍。

全书共分五篇，分别是分立电子元件、薄厚膜集成电路、压电铁电器件、传感器及表面组装元件和表面组装技术。

全书内容涉及面较宽，是电子技术、自动化、自动控制、检测与仪器、微电子技术等专业研究生和大学本科生的教材或教学参考书，同时对从事科研、生产和应用电子元气件的科技工作者和工程技术人员有较大的参考价值。

书籍目录

第一篇 分立电子元气件 第一章 绪论 第二章 电容器 第三章 电阻器 第四章 电感器 第二篇 薄厚膜集混合成电路 (HIC) 第五章 绪论 第六章 HIC的材料基础 第七章 HIC元、器件的平面图形设计 第八章 混合集成电路平面化布局的总体设计 第九章 混合集成电路的热设计 第十章 HIC的应用 第三篇 压电、热释电、铁电器件 第十一章 绪论 第十二章 压电器件 第十三章 热释电红外探测器 第十四章 铁电器件 第四篇 传感器 第十五章 绪论 第十六章 温度传感器 第十七章 气体传感器 第十八章 光传感器 第十九章 力学量传感器 第二十章 其他传感器 第五篇 表面组装元件 (SMT) 和表面组装技术 (SMC、SMD) 第二十一章 绪论 第二十二章 表面组装电阻器、电容器、电感器 第二十三章 表面组装半导体器件 第二十四章 其他片式元件 第二十五章 表面组装的设计 第二十六章 表面组装工艺概论 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>